

14.06.2005 - 11:00 Uhr

Infineon macht UMTS- Handys weltweit nutzbar

München (ots) -

Mit dem neuen Mobilfunkstandard UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) werden gemeinhin neue Leistungsmerkmale wie schnelle Datenübertragung und neue Anwendungen wie Aufnahme, Versand und Empfang von Videosequenzen oder Fernsehempfang für unterwegs verbunden. Universal heißt aber nicht automatisch, dass ein UMTS-Handy auch überall auf der Welt funktioniert. Insgesamt sechs Frequenzbereiche wurden festgelegt, in denen weltweit UMTS-Dienste angeboten werden. Um Handys der nächsten Generation im wahrsten Sinne des Wortes "universal" zu machen, hat Infineon jetzt einen neuen Chip vorgestellt, der auf nur 5mm x 5mm die Sende- und Empfangselektronik für alle sechs Frequenzbereiche unterbringt. SMARTi 3G heißt der smarte Chip, den Infineon auf einer Fachmesse in Kalifornien jetzt zum ersten Mal zeigte.

In Mobilfunkgeräten ist ein Hochfrequenz-Transceiver für das Senden und Empfangen der Signale verantwortlich. Transceiver setzt sich aus den beiden englischen Wörtern "transmit" für übertragen und "receive" für empfangen zusammen. Vor dem Senden wandelt der SMARTi 3G die elektronischen Signale für Sprache oder Daten in Hochfrequenzsignale um und verstärkt diese. Empfangene Hochfrequenzsignale setzt er in niederfrequente elektronische Signale um, die dann im Prozessor des Handys in Sprache und Daten umgewandelt werden.

Der SMARTi 3G ist in Mustern bereits verfügbar und wird von führenden Herstellern weltweit für die nächste Generation UMTS-Handys integriert. Infineon spielt bei der Sende- und Empfangselektronik im Handy eine führende Rolle. Im letzten Jahr hat das Unternehmen mehr als 170 Millionen Transceiver-Chips verkauft. Damit läuft etwa jedes vierte Handy weltweit mit einem Infineon-Transceiver.

Der SMARTi 3G-Chip wird in Silizium-Technik mit einer Strukturbreite von nur 130 Nanometer (ein Haar ist 500mal so dick) hergestellt. Mit 7,2 Megabit pro Sekunde erfüllt er die Anforderungen der nächsten Generation von UMTS-Telefonen bei der Datenübertragung von der Basisstation zum Mobilgerät. Der Chip wurde in Deutschland und Österreich entwickelt und wird in Frankreich produziert.

Diese Presseinformation und Pressefotos finden Sie unter http://www.infineon.com/press_deutsch/.

Pressekontakt:

Infineon Technologies AG
Media Relations Technology:
Monika Sonntag
Tel.: ++49 89 234-24497, Fax: -28482
monika.sonntag@infineon.com